

技术参数

5658/G5658 系列

日期: 08/2011

网址: www.stick1mat.com



应用

特点 单组份环氧树脂胶粘剂，流动性好，固化速度快，加热易返修，适用于 CSP/BGA & SMT 领域的底部填充

粘接材料 金属，陶瓷，玻璃，木料

典型应用 CSP/BGA & SMT 底部填充

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂胶粘剂	
外观	白色半透明液体	
粘度		
5658L	170 cps	20rpm@25°C, ASTM D-1084
5658	400cps	
5658H	1485 cps	
固化条件	1min@150°C; 5mins@120°C 15mins@100°C	
比重	1.10 g/ml	ASTM D-1875

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	白色半透明固体	
邵氏硬度	75D-80D	ASTM D-2240
玻璃化温度	65°C-85°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
线性膨胀系数	75 ppm/°C	TA Q400EM
降解温度	367°C	10% 重量损失
电学特性	数值	测试方法
体积电阻率	1.36×10E15 ohm*cm	IEC 60167:1964,IDT
表面电阻率	8.72×10E12ohm	IEC 60167:1964,IDT
介电常数	3.3@1GHz	
可靠性	数值	测试方法
吸水率	1%	ASTM D 570-98
工作温度范围	-55°C—150°C	

储运条件

使用方法 点胶，浸蘸，滚涂

储存方法 <-5°C，冷冻保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少解冻 2 小时，55ml 包装及以上的大包装解冻不少于 4 小时；

有效期 6 个月

技术参数

5658/G5658 系列

日期: 08/2011

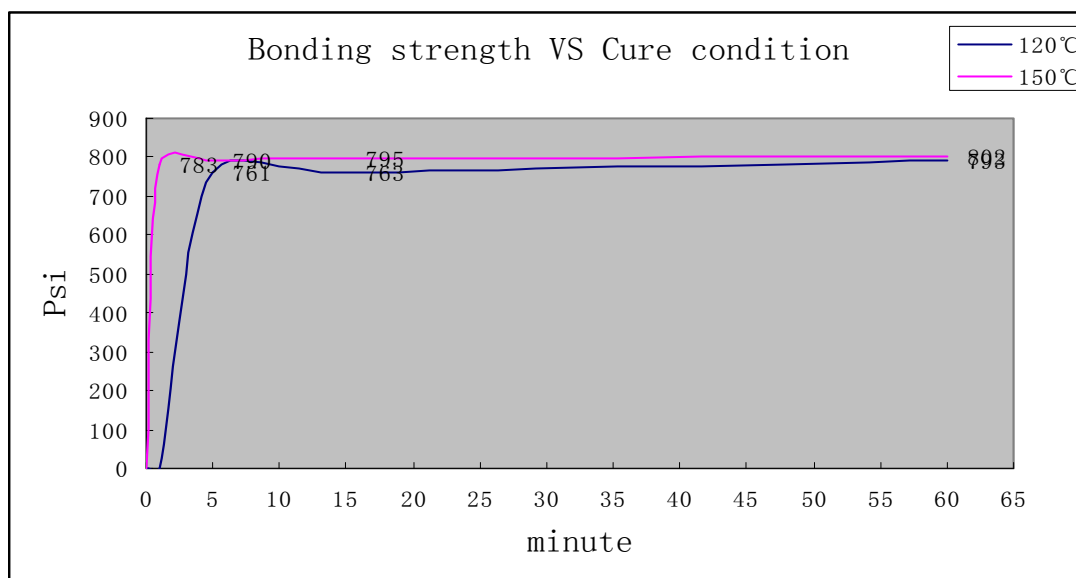
网址: www.stick1mat.com



包装

30ml 针筒装, 55ml 针筒装,

其他信息



注:

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺, 对于生产过程中因使用不当产生的任何问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。